

## TH-7010

### 单组份加热固化导电胶（FIP 导电胶）

#### 产品介绍

TH-7010 镍碳导电胶是一款单组分高温加热固化导电胶，在高温 150 摄氏度下 15 分钟条件下即可完全固化，有着良好的导电和屏蔽性能。原位固化自动点涂 FIP 导电胶是目前众多流行的电子产品 EMI 设计的典范，特别是需要内外部隔绝屏蔽以区分过程和信号发生功能。FIP 导电胶一般直接点在铸造，车削金属和导电塑料沟槽和表面起导电屏蔽作用。它提供了与导体表面极好的电子接触包括电子印刷线路板。FIP 导电胶被广泛应用于分区隔断和其它紧凑包装的电子设备，如军事，电讯，传输，航空航天和生命科学领域。FIP 导电胶技术可以让它精确地放置于指定位置，柔顺的衬垫可放在没有空间的狭小截面。他们在狭小截面和复杂图案的应用里为客户提供提供最经济的方案。点胶材料可以大大降低电子屏蔽衬垫的成本。耐用的高导电密封只有很低的压缩变形，确保电磁屏蔽和机械性能多年有效。

固化物具有出色的弹性和导电性，非常适合用为现场成型式防电磁波垫圈，如无线通讯基站中的铝铸元件、手机、平板电脑（PDA）、PCMCIA、GPS 导航、数码相框等设备中导电用途。使用的镀银铜粒子具有出色的导电性，并提供良好的电磁波隔绝性能。而且，对导电涂料膜、拉模铸造、金属镀层等各种基质具有良好的粘附性。

#### 特性

- 单组份加热快速固化
- 快速成模和样品，一般也不需要模具
- 出色而稳定的屏蔽效果，
- 于通常的壳体基材和涂层有极好的粘接性
- 弹性好，对反复压缩变形具有出色的复原性能，可使用的压缩率为50%以内。

## 产品特性

产品特性		技术参数
混合物	导电填料	镍碳
	粘合剂	硅树脂
	镍碳含量	>70%
	颜色	灰色
	比重(ASTM D1875)	2.4±0.1
固化	固化条件	150 °C×30 min
存储	存储条件 (冰箱)	-10 ~ 5°C
	有效期	6个月

## 固化物特性

固化物特性		技术参数
物理	邵氏硬度(ASTM D2240)	50±5
	压缩率 (ASTM D395 Method B)	10%~50%
		4.2 N/cm @ 40%
	断裂伸长率 (ASTM D412)	170%
	使用温度范围	-55 ~ 125°C
电气	体积电阻率(ASTM D2397)	0.03~0.05 Ω . cm

表面电阻(ASTM D257)	0.2~0.8 $\Omega \cdot \text{cm}$
电磁波隔绝率 (ASTM D4935)	90~100 dB

## 包装

本产品通常包装规格为 55ml 塑料针筒包装和 300ml 塑料管包装。

## 压缩率

**TH-7010** 能够保持单组份硅树脂的橡胶弹性。对反复压缩变形具有出色的复原能力。可使用的压缩率为 10 % ~ 50% , 推荐压缩率为 30% 。

## 注意

详细的安全事项请参考 Material Safety Data Sheets (MSDS : 材料安全数据表)。  
若需要 MSDS , 请与本公司联系。

- 注:
- 本文所载是我公司认为可靠的资料, 该产品说明中的数据为非出厂标准值。记载的内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
  - 我公司只对产品是否符合规格给予保证, 由于客户的使用条件不同和产品储存运输和施工过程不受本公司控制, 客户在使用时, 一定要先进行测试, 以确认适合您使用目的产品。
  - 产品的部分性能参数均可根据客户的要求作专门调整, 客户可与我公司的市场部联系。
  - 本公司的有机硅产品是面向一般电子工业用途而开发。如要作为其它用途, 必须按照相关的法律要求做出检测并符合要求, 方可使用。
  - 如果要转载本产品说明书更详细的内容, 请和本公司市场部联络。